

北京赛微电子股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

本次公司及旗下子公司拟继续向中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）申请合计不超过11亿元人民币的集团综合授信额度，期限为12个月；其中包括公司及旗下子公司不同主体申请使用的固定资产贷款、流动资金贷款、信用证等。

一、公司申请银行授信额度基本情况

公司拟向建设银行申请不超过3亿元的综合授信额度，期限为12个月。具体数额以公司根据资金使用计划与建设银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

二、子公司申请银行授信额度基本情况

1、北京赛积国际科技有限公司向建设银行申请授信额度的情况

公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）拟向建设银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度，期限为12个月，具体数额以赛积国际根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司向建设银行申请授信额度的情况
公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）拟向建设银行申请不超过5.5亿元的综合授信额度，期限为12个月，具体数额以赛莱克斯北京根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为上述子公司申请的综合授信额度提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该等子公司根据资金使用计划与建设银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

公司董事会授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相关子公司承担。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025年6月30日